

3.1 以产线牵引集成电路全链条突破

深入推进以张江为主体，以临港和嘉定为两翼的集成电路产业空间布局，持续推进集成电路关键装备市级科技重大专项，在集成电路与未来智能汽车等交叉领域加快布局，抢抓关键核心技术，实施重大基础科学问题研究与前沿技术攻关。



在研市级科技重大专项持续推进

光学忆阻器专项研发智能纳米光芯片基础原件光学忆阻器，突破钙钛矿纳米晶制备关键技术，成功制备第一代光学人工智能芯片，研究成果发表在《自然》(Nature)、《科学》(Science)等国际顶级期刊

未来车脑芯片专项瞄准集成电路与未来智能汽车交叉融合发展领域，开展未来智能车用高算力芯片的重大基础科学问题研究与前沿关键核心技术攻关

重大平台及工程加快建设

- 持续做强国家智能传感器创新中心平台功能，形成覆盖研发、中试到量产的集成电路重要产线布局
- 上海汽车芯片工程中心成立



关键技术取得重大突破

- 制备国内首片300mm射频SOI晶圆，突破300mm SOI晶圆制造技术
- 发布MEMS标准工艺模块及90nm硅光集成工艺2项国际先进水平技术成果
- 实现百兆比特率的实时量子密钥分发
- 助力“九章三号”量子计算原型机突破255个光子操纵